**深圳市联得自动化装备股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

证券简称：联得装备 证券代码：300545 编号：2019-007

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | █特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 □其他 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 参与单位名称及人员姓名 | 国联证券 董煜国联证券 曹源个人投资者 徐向阳个人投资者 杨静波 |
| 时间 | 2019年11月07日上午10:00 |
| 地点 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书：钟辉先生证券事务代表：杨晓芬女士 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **Q1：公司合作的客户有哪些？****A1**：公司具有优质、稳定的客户资源，与富士康、欧菲光、信利国际、京东方、深天马、蓝思科技、超声电子、南玻、长信科技、胜利精密、华为、苹果等平板显示行业知名厂商都建立了良好、稳定的合作伙伴关系。**Q2：公司今年的研发已投入多少？主要是哪些产品投入较多？****A2：**公司目前研发及技术人员413人，今年的研发投入已达到营业收入的9.2%，在研发投入方面还是呈持续增长的态势，主要是在半导体倒装设备和OLED相关生产设备的研发上投入较多。**Q3：请问公司和华为的合作主要在哪些方面？向华为提供哪些产品？****A3**：公司与华为公司建立了良好的合作关系，为华为提供的产品包括3D贴合设备、指纹模块自动组装设备、柔性手机装配线、自动点胶机、外观检测设备、UI检测设备以及其他测试及自动检测控制系统、终端自动化平台模组控制系统等。**Q4：公司未来业绩增长点是什么？****A4:一方面，**目前下游客户支持国产设备力度空前，为国内设备厂商提供了广阔的平台。京东方、维信诺等企业持续加大OLED面板生产线的投入使得公司有很大的市场机会。另一方面公司将加大半导体设备的研发投入，公司全资子公司Liande·J·R&D株式会社研发团队正在积极进行半导体后道封装设备的研发。目前研发成果已有半导体倒装设备和SFO光学系统检测机设备,前述产品均处于样机调试阶段，我们相信这些新产品能成为公司未来新的增长点之一。**Q5：公司未来的发展规划是什么？** **A5**：今年公司将持续加强在后段模组组装领域的设备研发，完善公司产品体系，积极开拓大尺寸TV设备、OLED平板显示模组组装设备、AOI检测设备市场以及半导体封装设备产品在新兴领域的应用市场，汽车电子领域方面进展也非常快。**Q6：公司偏贴事业部进展如何？****A6**: 偏贴设备的研发主要由日本研发团队负责。日本研发团队于2017年度已研发并推出OLED柔性偏贴设备，有关柔性偏贴方面有足够的技术储备。公司正建立轻资产战略模式，抓住自己的核心价值，充分利用各种资源，用有限的资产，获取最大收益。**Q7：公司的可转债募集资金使用在哪里？****A7**：根据公司的长期规划，可转债募集资金将使用在公司竞拍取得的深圳市龙华区观湖街道宗地号A909-0154土地上用于建设新型显示技术智能装备总部基地建设项目。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2019-11-08 |